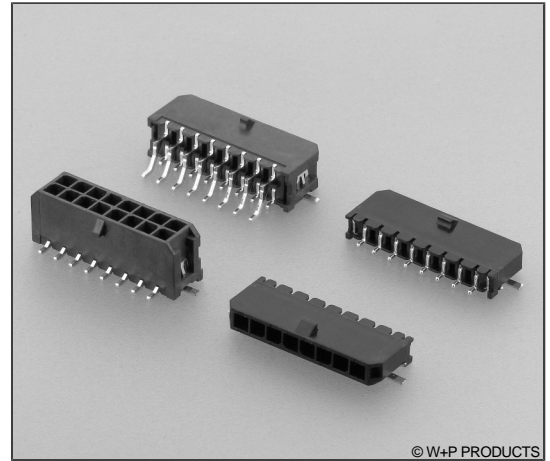


## SMT-Crimp-Rast-Stiftleisten RM 3,00mm, stehend/liiegend, 1-/2-reihig SMT Friction Lock Headers, 3.00mm Pitch, Vertical/Horizontal, Single/Double Row

### Technische Daten / Technical Data

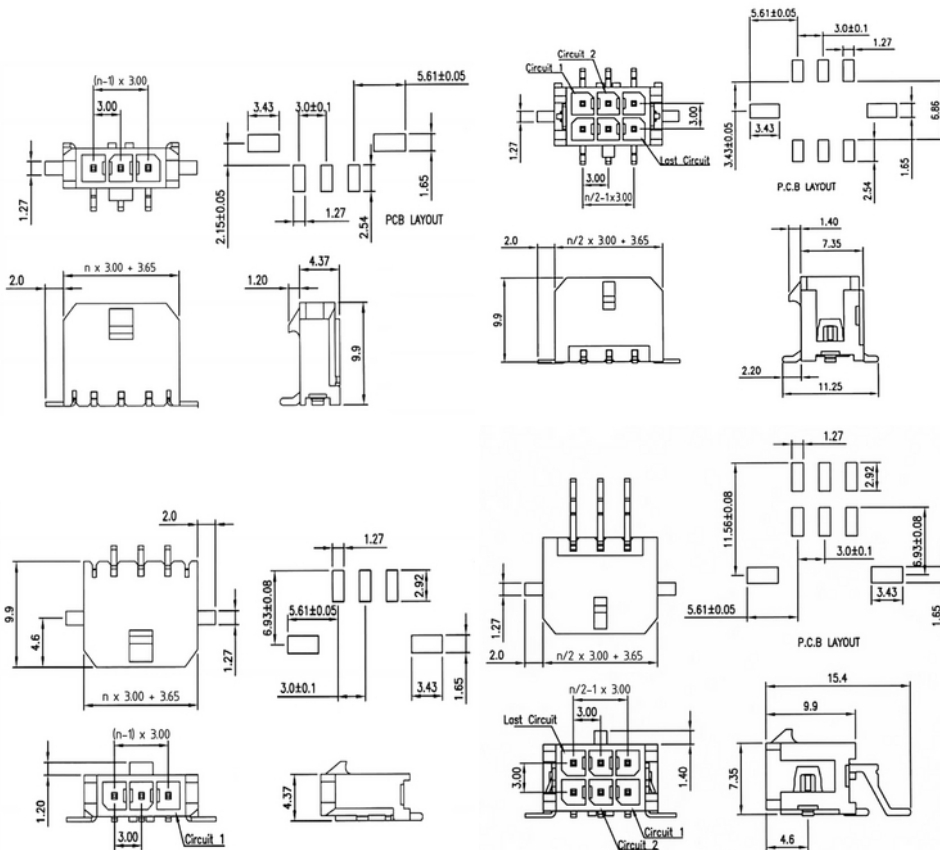
Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Messing
Contact Material	Brass
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Durchgangswiderstand	< 10mΩ
Contact Resistance	< 10mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	1,5kV <sub>AC</sub>
Test Voltage	1.5kV <sub>AC</sub>
Nennspannung	250V <sub>AC</sub>
Voltage Rating	250V <sub>AC</sub>
Nennstrom	5A
Current Rating	5A
Temperaturbereich	-25°C ... +85°C
Temperature Range	-25°C ... +85°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



© W+P PRODUCTS

Passende Gegenstecker:  
Compatible Connectors:

5833



<b>Series</b>	<b>Contacts*</b>	<b>Type*</b>	<b>Plating</b>	<b>Packing*</b>
<b>5830</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>PPTR</b>
	02-12 Einreihig Single row 02-24 Zweireihig Double row	1 Einreihig stehend Single row, vertical 2 Zweireihig stehend Double row, vertical 3 Einreihig liegend Single row, horizontal 4 Zweireihig liegend Double row, horizontal	50 Verzinkt Tin plated	TR Tape & Reel (Option) Tape & Reel (Option) PPTR Tape & Reel mit Pick&Place-Pads (Option) Tape & Reel with Pick&Place-Pads (Option)

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** - please replace by your specifications.

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

